

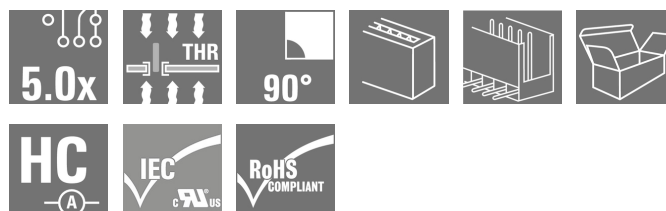
SL-SMART 5.0XHC/03/90 1.5SN BK BX**Weidmüller Interface GmbH & Co. KG**

Klingenbergstraße 26

D-32758 Detmold

Germany

www.weidmueller.com

Illustration du produit

Connecteur mâle modulaire résistant aux températures élevées. Conditionné en rouleau avec picot à souder 1,5 mm, optimisé pour l'implantation automatique, indiqué pour les applications de soudure par refusion. Les connecteurs mâles disposent d'espace pour les marquages et peuvent être codés. HC = Courant fort.

Informations générales de commande

Version	Connecteur pour circuit imprimé, Connecteur mâle, Ouvert latéralement, Raccordement soudé THT/THR, 5.08 mm, Nombre de pôles: 3, 90°, Longueur du picot à souder (l): 1.5 mm, étamé, noir, Boîte
Référence	1246110000
Type	SL-SMART 5.0XHC/03/90 1.5SN BK BX
GTIN (EAN)	4050118034554
Qté.	100 pièce(s)
Indices de produit	IEC: 400 V / 27.5 A UL: 300 V / 15 A

Emballage

Boîte

Date de création 4 novembre 2022 12:45:40 CET

SL-SMART 5.0XHC/03/90 1.5SN BK BX

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG

Klingenbergstraße 26

D-32758 Detmold

Germany

www.weidmueller.com

Caractéristiques techniques

Dimensions et poids

Profondeur	12 mm	Profondeur (pouces)	0,472 inch
Hauteur	9,8 mm	Hauteur (pouces)	0,386 inch
Hauteur version la plus basse	8,3 mm	Largeur	15 mm
Largeur (pouces)	0,591 inch	Poids net	1,28 g

Classifications

ETIM 6.0	EC002637	ETIM 7.0	EC002637
ETIM 8.0	EC002637	ECLASS 9.0	27-44-04-02
ECLASS 9.1	27-44-04-02	ECLASS 10.0	27-44-04-02
ECLASS 11.0	27-46-02-01	ECLASS 12.0	27-46-02-01

Caractéristiques du système

Famille de produits	OMNIMATE Signal - série BL/SL 5.08	Type de raccordement	Raccordement sur platine
Montage sur le circuit imprimé	Raccordement soudé THT/THR	Pas en mm (P)	5,08 mm
Pas en pouces (P)	0,2 inch	Angle de sortie	90°
Nombre de pôles	3	Nombre de picots par pôle	1
Longueur du picot à souder (l)	1,5 mm	Tolérance sur la longueur du picot à souder	0 / -0,3 mm
L1 en mm	10,16 mm	L1 en pouce	0,4 inch
Nombre de pôles	2	Degré de protection	IP20
Résistance de passage	≤5 mΩ	Codable	Oui
Force d'insertion/pôle, max.	8,5 N	Force d'extraction/pôle, max.	8 N

Données des matériaux

Matériau isolant	LCP GF	Couleur	noir
Tableau des couleurs (similaire)	RAL 9011	Groupe de matériaux isolants	IIIa
Indice de Poursuite Comparatif (CTI)	≥ 175	Moisture Level (MSL)	1
Classe d'inflammabilité selon UL 94	V-0	Matériau des contacts	CuMg
Surface du contact	étamé	Structure en couches du raccordement soudé	1...3 µm Ni / 2...4 µm Sn mat
Structure en couches du contact mâle	1...3 µm Ni / 2...4 µm Sn mat	Température de stockage, min.	-40 °C
Température de stockage, max.	70 °C	Température de fonctionnement, min.	-50 °C
Température de fonctionnement, max.	100 °C	Plage de température montage, min.	-30 °C
Plage de température montage, max.	100 °C		

Données nominales selon CEI

testé selon la norme	IEC 60664-1, IEC 61984	Courant nominal, nombre de pôles min. (Tu = 20 °C)	27,5 A
Courant nominal, nombre de pôles max. (Tu = 20 °C)	19 A	Courant nominal, nombre de pôles min. (Tu = 40 °C)	24 A
Courant nominal, nombre de pôles max. (Tu = 40 °C)	16,5 A	Tension de choc nominale pour classe de surtension/Degré de pollution II/2	400 V
Tension de choc nominale pour classe de surtension/Degré de pollution III/2	320 V	Tension de choc nominale pour classe de surtension/Degré de pollution III/3	250 V
Tension de choc nominale pour classe de surtension/Degré de pollution II/2	4 kV	Tension de choc nominale pour classe de surtension/Degré de pollution III/2	4 kV
Tension de choc nominale pour classe de surtension/Degré de pollution III/3	4 kV		

SL-SMART 5.0XHC/03/90 1.5SN BK BX

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG

Klingenbergstraße 26

D-32758 Detmold

Germany

www.weidmueller.com

Caractéristiques techniques

Données nominales selon CSA

Tension nominale (groupe d'utilisation B / CSA) 300 V

Courant nominal (groupe d'utilisation B / CSA) 15 A

Tension nominale (groupe d'utilisation D / CSA) 300 V

Courant nominal (groupe d'utilisation D / CSA) 15 A

Données nominales selon UL 1059

Institut (UR)



Certificat N° (UR)

E60693

Tension nominale (groupe d'utilisation B / UL 1059) 300 V

Courant nominal (groupe d'utilisation B / UL 1059) 15 A

Tension nominale (groupe d'utilisation D / UL 1059) 300 V

Courant nominal (groupe d'utilisation D / UL 1059) 10 A

Référence aux valeurs approuvées Les spécifications indiquent les valeurs maximales. Détails - voir le certificat d'agrément.

Emballage

Emballage	Boîte	Longueur VPE	40 mm
Largeur VPE	70 mm	Hauteur VPE	165 mm

Note importante

Conformité IPC

Conformité : les produits sont conçus, fabriqués et livrés selon des normes internationales reconnues ; et ils sont conformes aux caractéristiques garanties dans la fiche de données / respectent les propriétés décoratives selon IPC-A-610 « Classe 2 ». Des requêtes supplémentaires sur le produit peuvent être évaluées sur demande.

Remarques

- Surfaces de contact dorées sur demande
- Courant nominal par rapport à la section nominale et au Nb min. de pôles.
- Sur le schéma, P = pas
- Les données nominales se réfèrent au composant lui-même. Les lignes d'air et de fuite par rapport aux autres composants doivent être déterminées en tenant compte des normes applicables.
- Stockage à long terme du produit à une température moyenne de 50 °C et une humidité moyenne de 70 %, 36 mois

Agréments

Agréments



ROHS Conforme

UL File Number Search Site Web UL

Certificat N° (UR) E60693

Téléchargements

Données techniques [CAD data – STEP](#)Catalogue [Catalogues in PDF-format](#)Brochures [FL DRIVES EN](#)
[FL DRIVES DE](#)Livre blanc technologie de montage en surface [Download Whitepaper](#)

Date de création 4 novembre 2022 12:45:40 CET

Niveau du catalogue 25.10.2022 / Toutes modifications techniques réservées

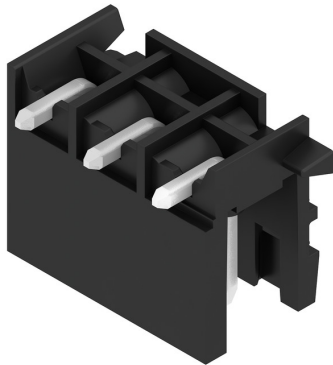
SL-SMART 5.0XHC/03/90 1.5SN BK BX

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG
Klingenbergstraße 26
D-32758 Detmold
Germany

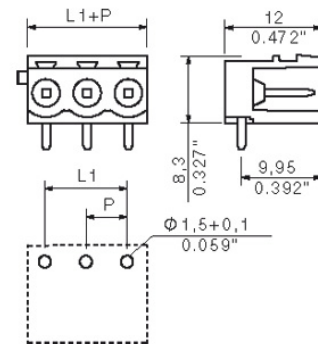
www.weidmueller.com

Dessins

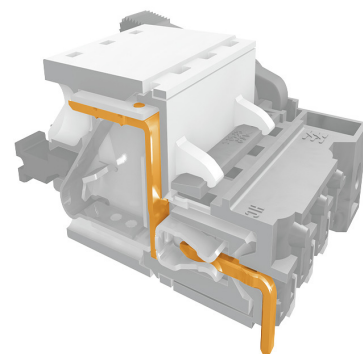
Illustration du produit



Dimensional drawing



Avantages produit



Safe power transmission
Proven properties

Recommended wave soldering profiles

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG
Klingenbergstraße 16
D-32758 Detmold
Germany
Fon: +49 5231 14-0
Fax: +49 5231 14-292083
www.weidmueller.com

Single Wave:



Double Wave:



Wave soldering profiles

Wired connection elements should be processed in accordance with the DIN EN 61760-1 standard. We have included two recommendations for practical wave soldering profiles, with which Weidmüller PCB terminals and connectors are qualified.

When choosing a suitable profile for your application, the following factors also need to be considered:

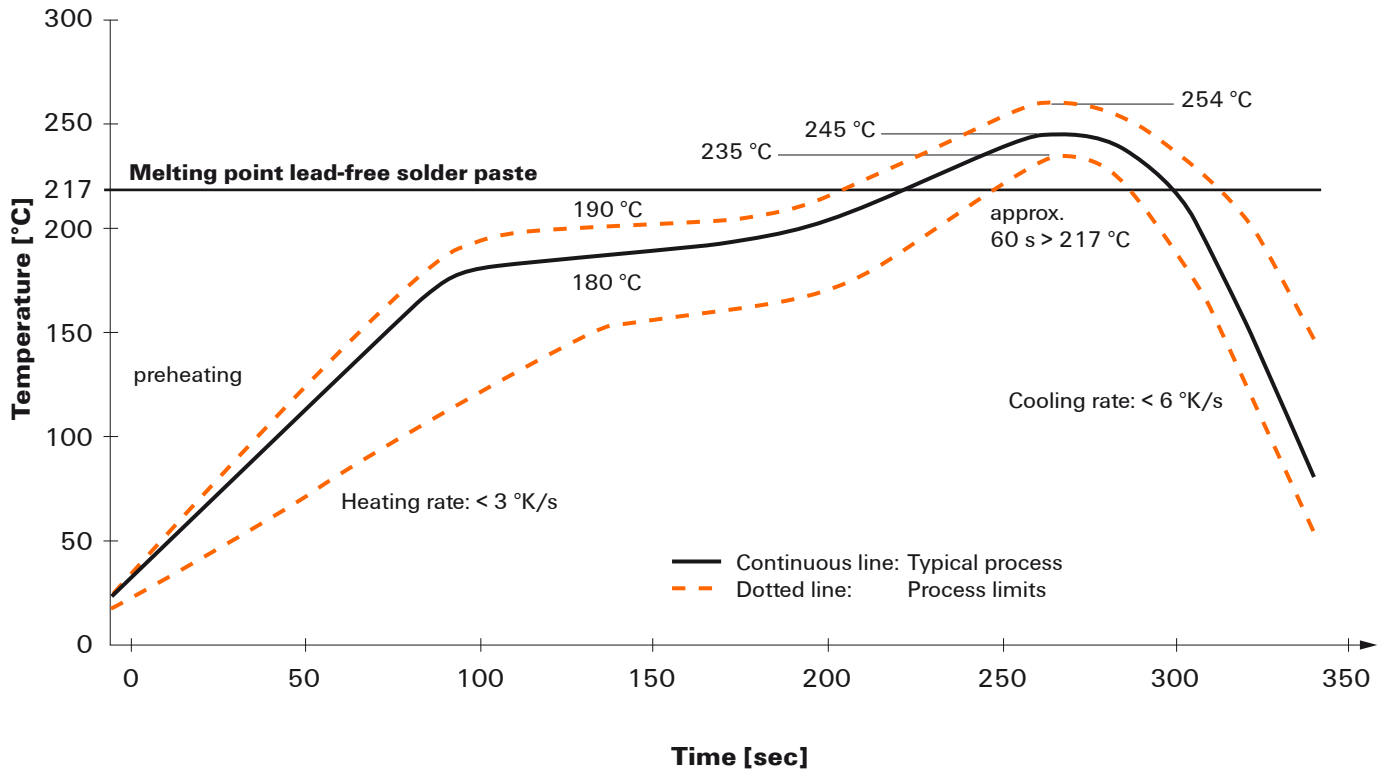
- PCB thickness
- Proportion of Cu in the layers
- Single/double-sided assembly
- Product range
- Heating and cooling rates

The single and double wave profiles each indicate the recommended operating range, including the maximum soldering temperature of 260°C. In practice, the maximum soldering temperature is quite often well below the above maximum profile.

We reserve the right to make technical changes.

Recommended reflow soldering profile

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG
Klingenbergstraße 16
D-32758 Detmold
Germany
Fon: +49 5231 14-0
Fax: +49 5231 14-292083
www.weidmueller.com



Reflow soldering profile

The perfect soldering profile for SMT Surface Mount Technology is one the most exiting question in SMT production. But there are more than one correct answer: The diagram of temperature-on-time is related to processing features of solder paste and to maximum load of components.

We have to consider the following parameters:

- Time for pre heating
- Maximum temperature
- Time above melting point
- Time for cooling
- Maximum heating rate
- Maximum cooling rate

We recommend a typical solder profile with associated process limits. With preheating components and board are prepared smoothly for the solder phase. Heating rate is typically $\leq +3\text{K/s}$. In parallel the solder paste is 'activated'. The time above melting point of 217°C the paste gets liquid and components and boards begin to connect. The maximum temperature of 245°C to 254°C should stay between 10 and 40 seconds. In the cooling phase at $\geq -6\text{K/s}$ solder is cured. Board and components cool down while avoiding cold cracks.